

2024年10月31日

各 位

JX金属株式会社

組織改正について

JX金属株式会社（社長：林 陽一、以下「当社」）は、半導体製造の先端パッケージング分野における新規事業の育成推進のため、本年11月1日付で「技術本部技術戦略部」内に「先端パッケージ材料事業推進室」を設置いたします。

生成AIの普及などを背景に、先端半導体のさらなる高性能化・小型化・低消費電力化が求められています。近年では、長年にわたり半導体の高機能化をけん引してきた前工程（シリコンウエハー上にトランジスタや配線を形成する工程）での技術革新に加え、後工程（半導体チップを基板に実装するパッケージング工程）においても、複数のチップを1つの基板上に高密度で実装するチップレットなど、さまざまな新手法が開発されており、こうした手法の高度化に向け、より高機能な材料が求められています。

当社の主力製品である半導体用スパッタリングターゲットは、パッケージング工程のひとつであるチップ間を繋ぐ配線等で需要の拡大が期待されていますが、この他にも、当社は同工程で採用される可能性のある様々な開発製品を有しています。今般設立する新組織においては、当社グループの先端パッケージ材料関連のマーケティングおよび開発に関する機能を一元化することにより、よりスピード感を持って、市場の要求に対応をしていきます。また、外部機関との連携も活用しながら、材料の新規開発や実用化に向けた取り組みを推進していきます。当社グループは、こうした活動を通じて、半導体材料分野における製品ラインナップの拡充を目指していきます。

以 上

